

『 内覧会の御案内 』

拝啓 初秋の候、貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、10月12日(火)～15日(金)の4日間、最新のレーザー切断機およびプラズマ切断機による切断実演を中心とした内覧会を開催致します。

今回の内覧会では、御好評いただいております発振器搭載型レーザー切断機『LMRV』にFANUC社製の新型レーザー発振器『C6000i-MODEL C』を搭載した最新機のご紹介をさせていただきます。

また、400A高品質プラズマ切断装置『HPR-400XD』による切断実演、インクジェットマーキング装置による文字印字・ラインマーキング実演、水素ガス切断機による切断実演・等を行います。

ご多用中誠に恐縮ではございますが、是非ご来場賜りますよう心よりお待ち申し上げます。

敬具

記

1. 開催日・時間 平成22年10月12日(火)～15日(金)
10:00～17:00
2. 開催場所 日酸TANAKA株式会社 本社構内
住所 埼玉県入間郡三芳町竹間沢11
電話 049(258)4412
3. 担当部署 FA事業部 FA国内営業部(担当:石川・甲田)
4. 展示商品
 - ・発振器搭載型レーザー切断機『LMRV-TF6000』
 - ・プラズマ切断機『PLASIAN α +HPR-400XD』
 - ・次世代ラインマーキング装置『インクジェットマーキング』
 - ・水素ガス切断機『KT-540J:水素切断仕様』
 - ・塗膜剥離機『ショットブラスト式』:参考展示
 - ・アークマシズ社製 配管自動溶接機『新型:モデル205』
 - ・フィールドワン殿協賛『販売管理&ミルシート管理システム』
 - ・大新技研殿協賛『ANS-Factory』
 - ・その他多数展示

—以 上—